

**Technical Datasheet for PCB-No.: 9471-01**

Date: 09.12.2021

PCB panel: ☐
Panel dimensions: 0.00 x 0.00 mm
Panel separation: ☐ V-Cut ☒ V-Scoring

PCBs per panel: 0 pieces
tolerance: +/- 0.2 mm

PCB dimensions.....: 51.78 x 50.87 mm
Base material: FR4

tolerance: +/- 0.2 mm

PCB thickness.....: 1.75 mm
Layer count: 4
Layer stack – multilayer.....: standard
PCB contour.....: milled contour

tolerance: +/- 0.1 mm

Copper outer layer.....: 18 µm
Copper inner layer.....: 18 µm

min. trace width: 150 µm
min. clearance.....: 200.00 µm

Hole count.....: 160 pieces
Hole diameters count.....: 8 pieces
Min. hole diameter.....: 0.1 mm

Plugged vias.....: ☐
Blind via count.....: 0 pieces
from layer to layer.....:
Buried via count.....: 0 pieces
from layer to layer.....:

Ø: 0.00 mm
min. Ø: 0.00 mm
min. Ø: 0.00 mm

Gold-finger connector count : 0 pieces
Pressfit technology: ☐

Overall length: 0.00 mm

Electrical test.....: ☒
Impedance check: ☐
Test certificate: ☐

Surface finish: ☒ chem. Ni / Au ☐ HAL leadfree ☐

SMD parts: top ☒ bot ☒
Solder mask: top ☒ bot ☒
Silkscreen.....: top ☒ bot ☒

Pad count: top 143 bot 62
Color: top green bot green
Color: top white bot white

Comments (manufacturing notifications):
milled dimensions: round diameter 51mm, with lugs > ~58mm total diam.

PCB Name / Title.....: AMC_Mainboard
Layouter: Marek Penno
Group:

Phone.: 7275



Data files count : 14

Nr.	Datei Name	Bezeichnung	Kommentar
01	9471-01_BOHR.ger	Bohrmaßbild	
02	9471-01_L01T.ger	Leiterbild Bestückungsseite, Top	
03	9471-01_L02i.ger	Leiterbild, Cu-Fläche, innen, Lage 2	
04	9471-01_L03i.ger	Leiterbild, Cu-Fläche, innen, Lage 3	
05	9471-01_L04B.ger	Leiterbild Lötseite, Bottom	
06	9471-01_LSM1.ger	Lötstopmmaske Bestückungsseite, Top	
07	9471-01_LSM2.ger	Lötstopmmaske Lötseite, Bottom	
08	9471-01_POS1.ger	Bestückungsdruck Bestückungsseite, Top	
09	9471-01_POS2.ger	Bestückungsdruck Lötseite, Bottom	
10	9471-01_SMD1.ger	Lötpastenmaske Bestückungsseite, Top	
11	9471-01_SMD2.ger	Lötpastenmaske Lötseite, Bottom	
12	ContourNonPlated.ncd	Fräsdaten nicht verkupfert	
13	ThruHoleNonPlated.ncd	Bohrdaten, nicht durchkontaktiert	
14	ThruHolePlated.ncd	Bohrdaten, durchkontaktiert	

Layer stackup:

1. (Xpedition -> Setup->Stackup Editor...->Edit->Copy Special->Manufacturing Documentation)
2. (Um den Stackup einfügen zu können, muss der Schutz in diesem Dokument zuerst aufgehoben werden)
3. (de: Überprüfen -> Bearbeitung einschränken -> Schutz aufheben)
(en: Review -> Restrict Editing -> Stop Protection)